



Automatic Dicing Saw DAD324

兼具超小的占地面积与功能性

从半导体晶圆到电子零件，使用于多样化的加工需求

最大可对应6寸的方形工作物

采用Y轴刻度规格(选配)、可实现高精度的指标控制

搭载标准高转矩2.0 kW主轴

使用于玻璃、陶瓷等难切削材料的加工。此外，也可选配高转速1.8 kW主轴

(最高回转速：60,000 min⁻¹)，为高使用性机器。

高生产效率

采用高性能MCU以提升软体运作速度与操作回应速度

PC搭载

- 通信对应 (选配)

采用新型NCS(Non-Contact Setup)以提高测量精确度并缩短测量时间

X, Y, Z轴皆采用伺服马达

- 各轴最高返回速度

X轴：800 mm/s、Y轴：200 mm/s、Z轴：80 mm/s

超小的占地面积

宽490 mm 的结构紧密设计

特别是将数台机器并列运行时，对单位面积生产力的提升有显著贡献。

※DISCO调查



操作方便

XIS(Extended Interface System)

操作按钮集中于显微镜页面

- Wafer Mapping

与全自动机型相同，以图示显示切割的进度状态

- Log Viewer

以图示表示类比数据，并可可视化切割参数

- Help Viewer

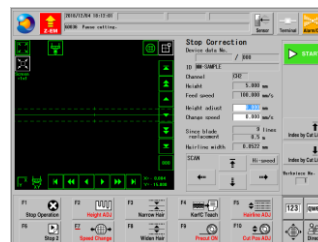
异常发生时显示对应措施，支援迅速且确实的系统状态恢复

- 自动校准

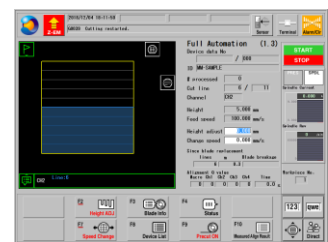
- 自动对焦

- 自动刀痕检查

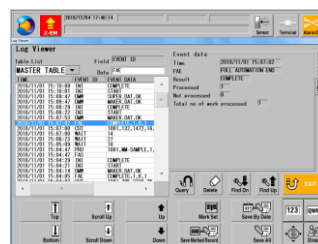
◆操作界面



XIS



Wafer Mapping



Log Viewer



Help Viewer

Specifications			
Specification		Unit	
Workpiece size		-	$\phi 6''$ (□6'' DPR)
X-axis	Cutting range	mm	160
	Cutting speed	mm/sec	0.1 ~ 800
Y-axis	Cutting range	mm	162
	Index step	mm	0.0001
	Index positioning accuracy	mm	0.005/160 (Single error)0.003/5
Z-axis	Max. stroke	mm	32.2
	Moving resolution	mm	0.00002
	Repeatability accuracy	mm	0.001
θ -axis	Max. rotating angle	deg	320
Spindle	Output	kW	2.0at40,000min ⁻¹
	Rated torque	N·m	0.48
	Revolution speed range	min ⁻¹	3,000~40,000
Machine dimensions(W × D × H)		mm	490 × 870 × 1,670
Machine weight		kg	Approx.420

■使用条件

- 请使用大气压露点在-10~-20 °C之间，残余有份为0.1 ppm，过滤度为0.01 μm/99.5%以上的清洁压缩空气。
 - 请将机械设备所在空间的室温设定在20 °C~25 °C之间，并将波动范围控制在±1以内。
 - 请将切削水的水温控制为室温+2 °C（波动范围在±1 °C以内），并将冷却水的水温控制为与室温相同（波动幅度在±1 °C以内）。
 - 此外，请避免设备受到冲击以及有感振动等的外部振动。并请不要将设备设置于风扇，通风口以及易于产生高热或油污等的装置附近。
 - 本设备将使用水。为了防范漏水造成的影响，请将设备设置于备有防水地板以及排水处理的场所。
- ※ 基于设备改善考量，本公司可能在不通知用户的情况下变更本规格。因此，请详细确认后再发出订单。
 ※ 压力皆以压力表指示压力值表示。
 ※ 关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司销售部门联络。